

# 全球与中国芯粒（Chiplet）产业竞争格局与投资效益预测报告2024-2030年

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 全球与中国芯粒（Chiplet）产业竞争格局与投资效益预测报告2024-2030年 |
| 公司名称 | 智信中科（北京）信息科技有限公司                          |
| 价格   | .00/件                                     |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 北京市朝阳区汤立路218号1层                           |
| 联系电话 | 010-84825791 18311257565                  |

## 产品详情

全球与中国芯粒（Chiplet）产业竞争格局与投资效益预测报告2024-2030年【全新修订】：2024年3月【出版机构】：中智信投研究网【内容部分有删减·详细可参中智信投研究网出版完整信息！】【报告价格】：[纸质版]:6500元 [电子版]:6800元 [纸质+电子]:7000元 (可以优惠) 【服务形式】：

文本+电子版+光盘【联系人】：顾滢滢 李雪免费售后

服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员内容简介：章 芯粒（Chiplet）产业相关概述1.1

芯片封测相关介绍1.1.1 芯片封测概念界定1.1.2 芯片封装基本介绍1.1.3 芯片测试主要内容1.1.4

芯片封装技术迭代1.2 芯粒（Chiplet）基本介绍1.2.1 芯粒基本概念1.2.2 芯粒发展优势1.2.3

与SoC技术对比1.3 芯粒（Chiplet）技术分析1.3.1 Chiplet集成技术1.3.2 Chiplet互连技术1.3.3

Chiplet封装技术第二章 2021-2024年Chiplet产业发展综合分析2.1 Chiplet产业发展背景2.1.1

中国芯片市场规模2.1.2 中国芯片产量规模2.1.3 中国芯片产业结构2.1.4 中国芯片贸易状况2.1.5

中美芯片战的影响2.2 Chiplet产业发展综述2.2.1 Chiplet芯片设计流程2.2.2 主流Chiplet设计方案2.2.3

Chiplet技术标准发布2.2.4 Chiplet市场参与主体2.3 Chiplet产业运行状况2.3.1 Chiplet市场规模分析2.3.2

Chiplet器件销售收入2.3.3 Chiplet市场需求分析2.3.4 Chiplet企业产品布局2.3.5 Chiplet封装方案布局2.4

Chiplet产业生态圈构建分析2.4.1 UCle产业联盟成立2.4.2 通用处理器企业布局2.4.3

云厂商融入Chiplet生态2.4.4 生态标准需持续完善第三章 2021-2024年中国芯片封测行业发展分析3.1

中国芯片封测行业发展综述3.1.1 行业重要地位3.1.2 行业发展特征3.1.3 行业技术水平3.1.4 行业利润空间3.2

中国芯片测封行业运行状况3.2.1 市场规模状况3.2.2 市场竞争格局3.2.3 企业市场份额3.2.4 封装价格状况3.3

中国先进封装行业发展分析3.3.1 行业发展优势3.3.2 市场规模状况3.3.3 市场竞争格局3.3.4

行业SWOT分析3.3.5 行业发展建议3.4 中国芯片封测行业发展前景趋势3.4.1 测封行业发展前景3.4.2

封装技术发展趋势3.4.3 先进封装发展前景3.4.4 先进封装发展方向第四章

2021-2024年半导体IP产业发展分析4.1 半导体IP产业基本概念4.1.1 产业发展地位4.1.2 产业基本概念4.1.3

产业主要分类4.1.4 产业技术背景4.1.5 产业影响分析4.2 半导体IP产业运行状况4.2.1 产业发展历程4.2.2

市场规模状况4.2.3 细分市场发展4.2.4 产品结构占比4.2.5 市场竞争格局4.2.6 市场需求分析4.2.7

商业模式分析4.2.8 行业收购情况4.3 半导体IP产业前景展望4.3.1 行业发展机遇4.3.2 行业需求前景4.3.3

行业发展趋势第五章 2021-2024年EDA行业发展分析5.1 全球EDA行业发展状况5.1.1 行业基本概念5.1.2

行业发展历程5.1.3 市场规模状况5.1.4 产品构成情况5.1.5 区域分布状况5.1.6 市场竞争格局5.2

中国EDA行业发展综述5.2.1 行业发展历程5.2.2 产业链条剖析5.2.3 行业制约因素5.2.4 行业进入壁垒5.2.5

行业发展建议5.3 中国EDA行业运行状况5.3.1 行业支持政策5.3.2 市场规模状况5.3.3 行业人才情况5.3.4 市场竞争格局5.3.5 行业投资状况5.4 中国EDA行业发展前景展望5.4.1 行业发展机遇5.4.2 行业发展前景5.4.3 行业发展趋势第六章 2021-2024年国际Chiplet产业重点企业经营状况分析6.1 超威半导体（AMD）6.1.1 企业发展概况6.1.2 产品发布动态6.1.3 2021年企业经营状况分析6.1.4 2022年企业经营状况分析6.1.5 2023年企业经营状况分析6.2 英特尔（Intel）6.2.1 企业发展概况6.2.2 2021年企业经营状况分析6.2.3 2022年企业经营状况分析6.2.4 2023年企业经营状况分析6.3 台湾集成电路制造股份有限公司6.3.1 企业发展概况6.3.2 2021年企业经营状况分析6.3.3 2022年企业经营状况分析6.3.4 2023年企业经营状况分析第七章 2020-2024年中国Chiplet产业重点企业经营状况分析7.1 芯原微电子（上海）股份有限公司7.1.1 企业发展概况7.1.2 经营效益分析7.1.3 业务经营分析7.1.4 财务状况分析7.1.5 核心竞争力分析7.1.6 公司发展战略7.1.7 未来前景展望7.2 江苏长电科技股份有限公司7.2.1 企业发展概况7.2.2 业务发展动态7.2.3 经营效益分析7.2.4 业务经营分析7.2.5 财务状况分析7.2.6 核心竞争力分析7.2.7 公司发展战略7.2.8 未来前景展望7.3 天水华天科技股份有限公司7.3.1 企业发展概况7.3.2 经营效益分析7.3.3 业务经营分析7.3.4 财务状况分析7.3.5 核心竞争力分析7.3.6 公司发展战略7.3.7 未来前景展望7.4 通富微电子股份有限公司7.4.1 企业发展概况7.4.2 业务发展动态7.4.3 经营效益分析7.4.4 业务经营分析7.4.5 财务状况分析7.4.6 核心竞争力分析7.4.7 公司发展战略7.4.8 未来前景展望7.5 中科寒武纪科技股份有限公司7.5.1 企业发展概况7.5.2 经营效益分析7.5.3 业务经营分析7.5.4 财务状况分析7.5.5 核心竞争力分析7.5.6 公司发展战略7.5.7 未来前景展望7.6 北京华大九天科技股份有限公司7.6.1 企业发展概况7.6.2 经营效益分析7.6.3 业务经营分析7.6.4 财务状况分析7.6.5 核心竞争力分析7.6.6 公司发展战略7.6.7 未来前景展望第八章 中国Chiplet产业典型相关投资项目深度解析8.1 集成电路先进封装晶圆凸点产业化项目8.1.1 项目基本概况8.1.2 项目投资必要性8.1.3 项目投资可行性8.1.4 项目投资概算8.1.5 项目经济效益8.2 高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目8.2.1 项目基本概况8.2.2 项目投资必要性8.2.3 项目投资可行性8.2.4 项目投资概算8.2.5 项目进度安排8.3 高性能模拟IP建设平台8.3.1 项目基本概况8.3.2 项目投资可行性8.3.3 项目投资概算8.3.4 项目进度安排第九章 2024-2030年中国Chiplet产业投资分析及发展前景预测9.1 中国Chiplet产业投资分析9.1.1 企业融资动态9.1.2 投资机会分析9.1.3 投资风险提示9.2 中国Chiplet产业发展前景9.2.1 行业发展机遇9.2.2 产业发展展望图表目录图表 集成电路封装实现的四大功能图表 集成电路测试的主要内容图表 集成电路测试可分为晶圆测试和成品测试图表 集成电路封装技术发展阶段图表 Chiplet内部结构图表 Chiplet技术主要功能分析图表 服务器CPU、GPU裸Die尺寸逐渐增大图表 晶圆利用效率和芯片良率随着芯片面积缩小而提升图表 基于7nm工艺的传统方案及Chiplet方案下良率及合计制造成本对比图表 SoC技术与Chiplet技术关系示意图图表 Chiplet及单片SoC方案环节对比图表 水平和垂直方向集成的Chiplet的结构图表 Chiplet中SerDes互连电路结构图表 Chiplet并行互连电路结构图表 当前Chiplet间主要互连方案比较图表 先进封装技术对比图表 主流Chiplet底层封装技术图表 2017-2023年中国集成电路产业销售额及增速图表 2016-2023年中国集成电路产量统计图图表 2014-2023年中国集成电路产业结构图表 2013-2023年中国集成电路进口数量及增速图表 2015-2023年中国集成电路进口金额及增速图表 Chiplet芯片设计流程图表 主流Chiplet设计方案图表 中国Chiplet产业主要参与者介绍图表 2018-2035年全球Chiplet芯片市场规模预测图表 2020-2024年基于Chiplet技术半导体器件销售收入及预测图表 晶体管器件生产单价与但芯片晶体管数量的关系图表 各制程每百万颗芯片制造成本图表 先进制程芯片设计成本快速上升图表 鲲鹏920参数图表 台积电3DFabric平台图表 台积电CoWoS-S架构图表 台积电InFO\_PoP及InFO\_B（bottom only）架构图表 台积电InFO\_OS架构图表 台积电3D芯片堆叠SoIC图表 三星电子封装布局历史沿革图表 三星电子3D IC解决方案图表 日月光FOCoS解决方案图表 Amkor SLIM/SWIFT解决方案图表 2016-2023年中国芯片封装测试业市场规模及增速图表 中国芯片封测行业竞争格局图表 2023年全球封装测试企业图表 2023年全球半导体封测企业图表 中高阶封装形式用途和价格图表 先进封装与传统封装简单对比图表 2016-2023年中国先进封装市场规模及增速图表 2016-2023年中国先进封装规模占全球规模比重情况图表 台积电先进封装技术一览表 国内大陆封测厂技术平台图表 2023年SiP市场份额（按厂商类型）图表 集成电路封装产业发展趋势图表 先进封装发展方向图表 半导体IP位于半导体产业地位图表 半导体IP作用与特征图表 IP核分类图表

IP按产品分类图表 1971-2023年全球集成电路制程发展历史图表 不同工艺节点芯片集成IP数量走势图  
集成电路IP产业链价值分布图表 IP行业发展历程图表 2019-2023年全球芯片设计IP销售额及增长率图表  
2015-2023年全球处理器IP市场规模及增速图表 2015-2023年全球接口IP市场规模及增速图表  
2015-2023年全球其他物理IP板块市场规模及增速图表  
2015-2023年全球其他数字IP板块市场规模及增速图表 2023年全球半导体IP产品结构占比图表  
2023年全球半导体IP市场份额占比情况图表 国内细分领域主要半导体IP企业图表  
主要IP厂商覆盖产品类别图表 半导体厂商外购IP产品的关键考量图表 IP行业商业模式图表 ARM  
IP授权收费模式图表 IP厂商授权与版税收入占比图表 IP行业主要收购事件图表 IP行业主要玩家变化图表  
EDA工具分类图表 全球EDA行业发展历程图表 2012-2023年全球EDA市场规模图表  
2017-2023年全球EDA市场产品构成情况图表 2017-2023年全球EDA市场区域分布情况图表  
2023年全球EDA企业市场份额占比情况图表 中国EDA行业发展历程图表 中国EDA产业链图表  
2020-2023年中国EDA行业相关政策汇总图表 2016-2023年中国EDA市场规模图表  
2018-2023年中国EDA行业人才情况图表 中国EDA行业竞争梯队图表 2023年中国EDA市场竞争格局图表  
2018-2023年中国EDA行业投资事件数量及金额图表 2019-2023年AMD综合收益表图表  
2019-2023年AMD分部资料图表 2019-2023年AMD收入分地区资料图表 2020-2023年AMD综合收益表图表  
2020-2023年AMD分部资料图表 2020-2023年AMD收入分地区资料图表 2021-2023年AMD综合收益表图表  
2021-2023年AMD分部资料图表 2021-2023年AMD收入分地区资料图表 2019-2023年英特尔综合收益表图表  
2019-2023年英特尔分部资料图表 2019-2023年英特尔收入分地区资料图表  
2020-2023年英特尔综合收益表图表 2020-2023年英特尔分部资料图表  
2020-2023年英特尔收入分地区资料图表 2021-2023年英特尔综合收益表图表  
2021-2023年英特尔分部资料图表 2021-2023年英特尔收入分地区资料图表  
2019-2023年台湾集成电路制造股份有限公司综合收益表图表  
2019-2023年台湾集成电路制造股份有限公司分部资料图表  
2019-2023年台湾集成电路制造股份有限公司收入分地区资料图表  
2020-2023年台湾集成电路制造股份有限公司综合收益表图表  
2020-2023年台湾集成电路制造股份有限公司分部资料图表  
2020-2023年台湾集成电路制造股份有限公司收入分地区资料图表  
2021-2023年台湾集成电路制造股份有限公司综合收益表图表  
2021-2023年台湾集成电路制造股份有限公司分部资料图表  
2021-2023年台湾集成电路制造股份有限公司收入分地区资料图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司总资产及净资产规模图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司营业收入及增速图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司净利润及增速图表  
2021-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司营业利润及营业利润率图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司净资产收益率图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司短期偿债能力指标图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司资产负债率水平图表  
2019-2023年芯原微电子（上海）股份有限公司运营能力指标图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司总资产及净资产规模图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司营业收入及增速图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司净利润及增速图表  
2021-2023年江苏长电科技股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司营业利润及营业利润率图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司净资产收益率图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司短期偿债能力指标图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司资产负债率水平图表  
2019-2023年江苏长电科技股份有限公司运营能力指标图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司总资产及净资产规模图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司营业收入及增速图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司净利润及增速图表

2021-2023年天水华天科技股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司营业利润及营业利润率图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司净资产收益率图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司短期偿债能力指标图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司资产负债率水平图表  
2019-2023年天水华天科技股份有限公司运营能力指标图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司总资产及净资产规模图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司营业收入及增速图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司净利润及增速图表  
2021-2023年通富微电子股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司营业利润及营业利润率图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司净资产收益率图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司短期偿债能力指标图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司资产负债率水平图表  
2019-2023年通富微电子股份有限公司运营能力指标图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司总资产及净资产规模图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司营业收入及增速图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司净利润及增速图表  
2021-2023年中科寒武纪科技股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司营业利润及营业利润率图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司净资产收益率图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司短期偿债能力指标图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司资产负债率水平图表  
2019-2023年中科寒武纪科技股份有限公司运营能力指标图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司总资产及净资产规模图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司营业收入及增速图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司净利润及增速图表  
2021-2023年北京华大九天科技股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司营业利润及营业利润率图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司净资产收益率图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司短期偿债能力指标图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司资产负债率水平图表  
2019-2023年北京华大九天科技股份有限公司运营能力指标图表  
高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目总投资图表  
高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目具体进度安排图表 高性能模拟IP建设平台项目总投资图表  
高性能模拟IP建设平台项目具体进度安排图表 Chiplet重塑产业链预测